

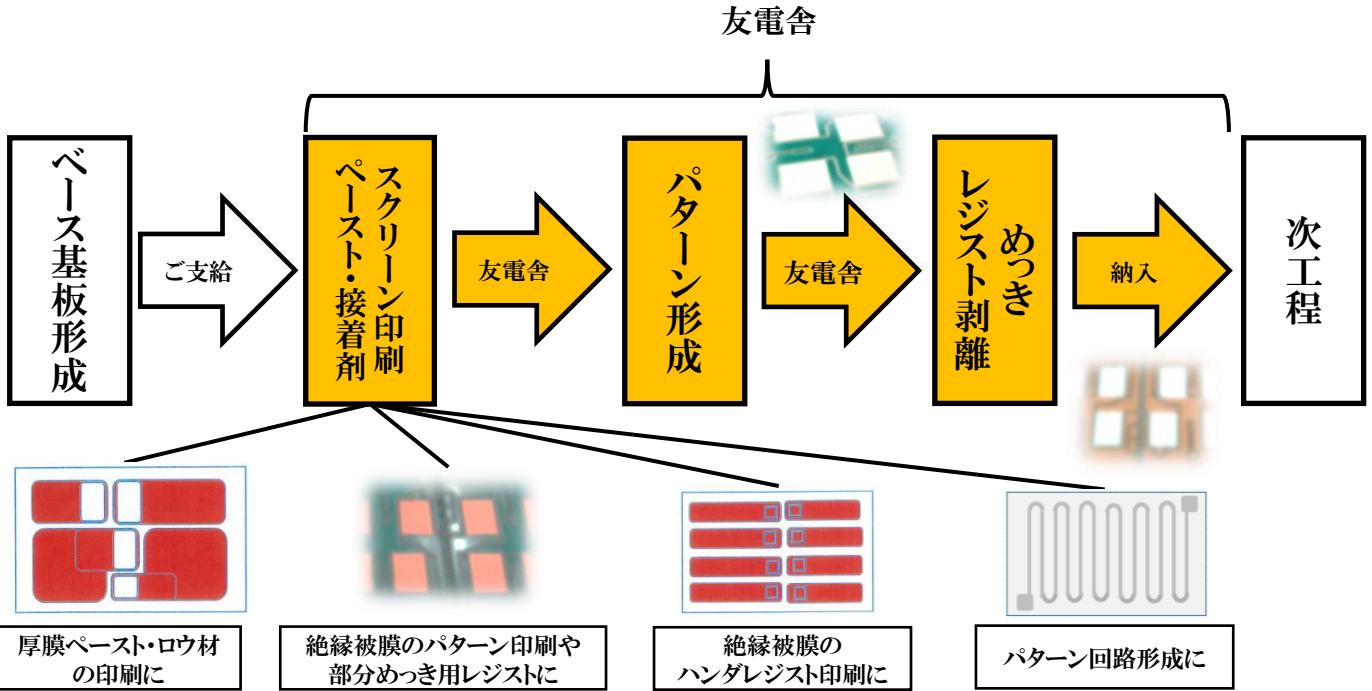
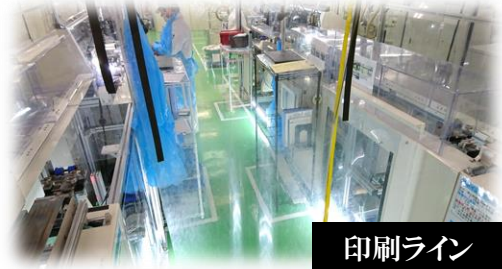
～ パワーデバイス・LED基板のパターニング(接合・メタライズ・レジスト etc.) から、後工程のめっきまで ～

# 放熱・絶縁基板の連続スクリーン印刷

近年、パワーデバイス等の市場拡大に向け絶縁・放熱基板の開発が活発になっております。

弊社では、長年の実績がある「めっき」と「スクリーン印刷」による成膜技術の組み合わせでお応えすべく用途開発を進めております。

量産を前提としたサンプルをご提案・提供させて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。



**用途**  
 パワーデバイス基板  
 高出力LED基板  
 シールドケース 等

**印刷仕様 概略**

位置精度(自動補正): ±30 μm  
 印刷 有効寸法: 250×400mm  
 印刷可能な板厚(t)  
 ロール材: ~0.2mm  
 枚葉 : ~4mm  
 硬化方式: UV硬化/熱硬化(乾燥)  
 自動検査装置

スクリーン印刷例(絶縁)

**めっき種 概略**

(無電解めっき: 下地・仕上げめっき)  
 銅(Cu) / 銀(Ag) / 金(Au)  
 ニッケル(Ni-p・Ni-B) / 錫(Sn)

(電解めっき: 仕上げめっき)  
 銅(Cu) / 銀(Ag) / 金(Au)  
 ニッケル(Ni) / 錫(Sn)

～不可能への挑戦～  
 株式会社 友電舎  
 大阪市此花区常吉2丁目4番8号  
 TEL: 06-6465-1663  
 Mail: joho1@ydn.co.jp  
 URL: http://www.ydn.co.jp

